

# OKTEK 808 膠 & 808 膠片

軟性電路板(FPC)SMT加工最佳解決方案  
您在軟板SMT製程中的困擾, 我們來幫您解決!!



使用高溫膠帶黏貼, 造成殘膠問題  
過爐後基板變形, 零件位移空焊  
良率無法提升, 交期拉長  
生產成本上升, 無法有效改善

感謝各手機, 記憶卡, 相機等軟板大廠採用

OKTEK 808 膠 通過 SGS RoHS 六大禁用有害物質檢驗。  
OKTEK 808 膠片 報告號碼: CE/2010/050244

## 貼附性佳

808膠可依軟板厚薄不同, 調整適合的黏度, 取放軟板不變形。

## 無殘膠污染

特殊耐高溫材料配方, 不殘膠。

## 有效降低成本

可重複使用, 多次使用後依然保有自黏性, 除膠容易, 重新塗佈, 載板可再度使用, 不浪費。

## 良率提升

載板可完全貼附於載板上, 不變形造成位移空焊

1. 將待加工之軟性電路板放置於塗覆有808膠之輔助載板上
4. 將載板回收使用 (808膠可隨同基板回收使用)

